

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-020

精伦电子股份有限公司

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告如下：

一、本次贷款的基本情况

为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以自有房产抵押，向湖北银行武汉东湖开发区支行申请办理流动资金贷款 1000 万元，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式、抵押信息等事项以双方签署的合同为准。

公司与湖北银行武汉东湖开发区支行不存在关联关系，不构成关联交易，本次抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、抵押资产情况

本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司 2 栋房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131986 号。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、对上市公司的影响

本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日